



Tagesordnung

Thema: 66. Treffen des Arbeitskreises
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und
Verbindungstechnologien“

Datum: **06.05.2019, 10.00 Uhr**

Ort: NCC Ost, Messe Nürnberg

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Untersuchung der belastungsabhängigen Rissinitiierung in
Leiterplattenbasismaterialien
Herr Schmidt, Robert Bosch GmbH, Renningen
- 3 10:50 Uhr
Was müssen smarte Sensoren für Condition Monitoring können?
Herr Brand, Analog Devices,
- 4 11:30 Uhr
Tracability in der elektronischen Baugruppenfertigung
Herr Kraus, Kraus Hardware GmbH, Großostheim
- 5 12:10 Uhr
Mittagessen

- 6 13:10 Uhr
Beschleunigtes Testen von Loten
Herr Schambeck, BMW Group, München
- 7 13:50 Uhr
Hochstrom-, Wärme- und 3D-Leiterplatten im praktischen Einsatz
Herr Hörth, KSG Austria GmbH, Gars am Kamp
- 8 14:30 Uhr
Kaffeepause
- 9 15:00 Uhr
Herausforderungen bei der Verarbeitung von SOT- und SOD- Bauelementen
Herr Hippin, Endress+Hauser SE+Co. KG, Maulburg
- 10 15:40 Uhr
Elektrochemische Analytik
Frau Kolbinger, Fraunhofer IZM, Berlin
- 11 16:20 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr